

AP-9770（711FH）技术参考资料

1. 概述

AP-9770(711FH)是一款单组份紫外光固化改性丙烯酸酯胶粘剂，专为高可靠性电子封装设计。固化后形成的柔性粘接层兼具卓越的抗振动、抗冲击性能，并能在极端环境下提供防潮、防水、绝缘等多重保护，是精密电子元件、柔性电路板（FPC）及复杂工业应用场景的理想选择。

2. 特性

- 高效的紫外固化，固化速度快，提升生产效率。
- 多重防护性能：兼具防潮、防水、绝缘功能，耐冷热冲击（-40℃~125℃）及双85测试（85℃/85%RH）。
- 高可靠性粘接，抗振动与冲击，适配柔性基材与复杂工况。

3. 应用领域

- 广泛应用于电子元器件粘接与封装（如传感器、微型电路模块、柔性电路板）、尤其适用于需快速固化、耐环境老化，抗冲击振动的工业及消费电子领域。

4. 性能参数

固化前典型特性	AP-9770（711FH）	测试条件及概述
1.外观	透明液体	目视
2.气味	无刺激性气味	/
3.粘度@25℃（cps）	11000±1000	GB/T 2794-1995
4.触变指数@25℃	3.5	GB/T 2794-1995
5.储存有效期（months）	6	干燥环境光储存
固化后典型特性	AP-9770（711FH）	测试条件及概述
1.外观	透明固体	目视
2.硬度（Shore D）	55±5	GB/T 2411-2008
3.吸水率@25℃，24h（%）	≤1.5	GB/T 1034-2008
4.拉伸模量（MPa）	≥4	ASTM D638-14
5.线膨胀系数@-30~100℃（μm/（m·℃））	101	ASTM D831-19
6.介电强度（kV/mm）	≥50	GB/T 1408.1-2016
7.体积电阻率（Ω·cm）	≥1×10 ¹⁴	GB/T 31838-2019
8.剪切强度（PI膜/PC）@25℃（Mpa），平均值	≥2	GB/T 7124-2008
9.剥离强度（PI膜/玻璃）@25℃（N），平均值	≥32	GB/T 2790-1995
10.剥离强度（PI膜/玻璃）@60℃（N），平均值	≥22	GB/T 2790-1995
11.冷热冲击（-40℃~125℃，200cycles）剥离强度（PI膜/玻璃）@25℃（N），平均值	≥70	GB/T 2790-1995



12.冷热冲击（-40℃~125℃， 500cycles）剥离强度（PI膜/玻璃）@25℃（N），平均值	≥52	GB/T 2790-1995
13.冷热冲击（-40℃~125℃， 1000cycles）剥离强度（PI膜/玻璃）@25℃（N），平均值	≥35	GB/T 2790-1995
14.冷热冲击（-40℃~125℃， 500cycles）+泡水500h；剥离强度（PI膜/玻璃）@25℃（N），平均值	≥35	GB/T 2790-1995
15.双85测试（85℃/85%RH， 200h）剥离强度（PI膜/玻璃）@25℃（N），平均值	≥40	GB/T 2790-1995
16.双85测试（85℃/85%RH， 500h）剥离强度（PI膜/玻璃）@25℃（N），平均值	≥43	GB/T 2790-1995
17.双85测试（85℃/85%RH， 1000h）剥离强度（PI膜/玻璃）@25℃（N），平均值	≥22	GB/T 2790-1995

上述数据仅可视为产品典型值，不当作为技术规格使用。

5. 典型固化条件

推荐固化条件	条件
推荐UV固化条件	光源波长395nm或365nm， 10~20s， 光强1000~1500mW/cm ² 。

备注：固化效果受紫外线强度、光源距离、基材透明度及胶层厚度影响，建议根据实际工况优化参数。

6. 使用和储存

- ◆ 施胶和固化过程需在通风良好的环境中进行，避免密闭空间。
- ◆ 施胶前需彻底清除基材表面的焊剂残留、油脂及脱模剂等污染物，确保基材清洁、干燥且无油脂。
- ◆ 产品应储存于阴凉、干燥，避光处。产品开封后建议24h内使用完。
- ◆ 自生产之日起，产品在未开封的原始容器中储存于5~28℃，保质期6个月。

7. 运输

- ◆ 在运输过程中该产品放在干燥环境下的避光包装材料中进行。

8. 包装规格

- ◆ 包装规格包括30cc/支、50cc/支、1L/罐、其他特殊包装请联系我们。

特别声明：

本数据基于实验室标准条件测定，实际应用可能因环境差异略有不同。建议用户在使用前进行适配性测试。如需技术支持，请与公司深圳总部联系。